

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成22年5月27日(2010.5.27)

【公開番号】特開2008-263049(P2008-263049A)

【公開日】平成20年10月30日(2008.10.30)

【年通号数】公開・登録公報2008-043

【出願番号】特願2007-104522(P2007-104522)

【国際特許分類】

H 0 1 L 41/09 (2006.01)

B 4 1 J 2/16 (2006.01)

B 4 1 J 2/045 (2006.01)

B 4 1 J 2/055 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 41/08 J

B 4 1 J 3/04 1 0 3 H

H 0 1 L 41/08 U

B 4 1 J 3/04 1 0 3 A

【手続補正書】

【提出日】平成22年4月9日(2010.4.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

溝部が形成され、前記溝部の底面に電極が設けられた基板と、
前記電極に電氣的に接続されたフレキシブル基板と、
貫通孔が形成され、前記溝部にて前記フレキシブル基板上に設けられた弾性部材と、
前記溝部に設けられ、前記貫通孔に充填された熱硬化性樹脂材料と、
を備え、
前記弾性部材の一部は、前記熱硬化性樹脂材料から露出していることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

前記弾性部材は、フッ素ゴム、シリコンゴム及びアクリルゴムのいずれかであることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 3】

前記貫通孔は、前記溝部が延びる方向に沿って複数形成されていることを特徴とする請求項 2 に記載の半導体装置。

【請求項 4】

溝部が形成され、前記溝部の底面に電極が設けられた基板と、
前記電極に電氣的に接続されたフレキシブル基板と、
貫通孔が形成され、前記溝部にて前記フレキシブル基板上に設けられた弾性部材と、
前記溝部に設けられ、前記貫通孔に充填された熱硬化性樹脂材料と、
を備え、
前記弾性部材の一部は、前記熱硬化性樹脂材料から露出していることを特徴とする液滴吐出装置。

【請求項 5】

溝部の底面上に設けられた電極とフレキシブル基板とが電氣的に接続された半導体装置の製造方法において、

前記電極の上面に、熱硬化性樹脂材料を塗布する樹脂材料塗布工程と、

前記熱硬化性樹脂材料を介して前記電極の上方に、前記フレキシブル基板および弾性部材を順に載置する載置工程と、

前記弾性部材に形成された貫通孔に前記熱硬化性樹脂材料が充填されるように前記弾性部材を介して前記フレキシブル基板を前記電極に向かって押圧しつつ、前記熱硬化性樹脂材料を加熱する加圧・加熱工程とを有し、

前記加圧・加熱工程にて、前記弾性部材の一部を、前記熱硬化性樹脂材料から露出させることを特徴とする半導体装置の製造方法。